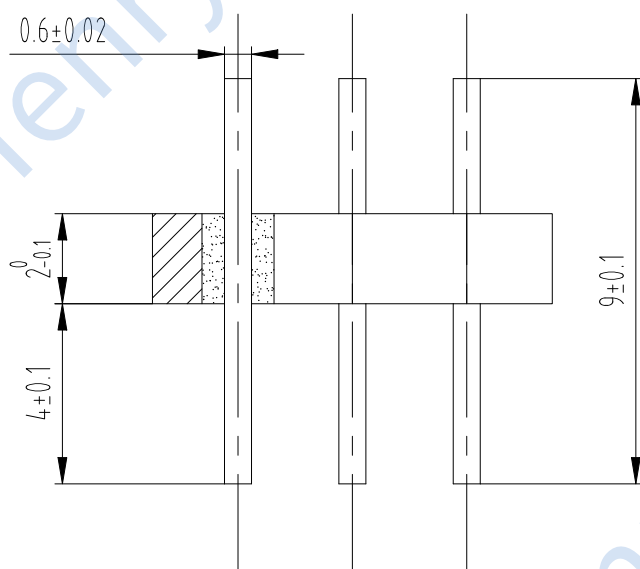
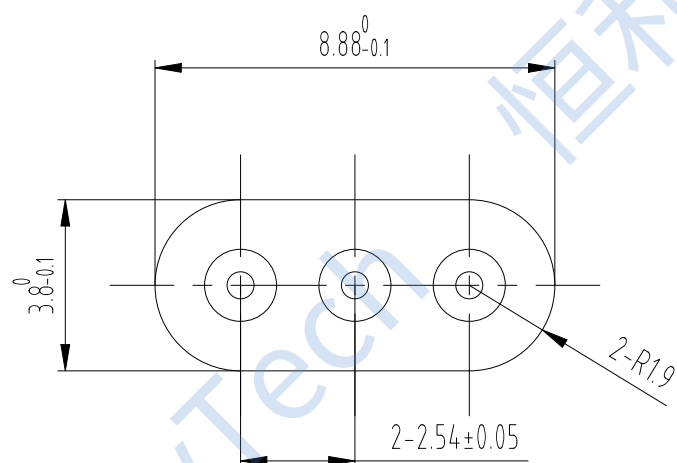




技术要求：

1. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
2. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
3. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
4. 使用寿命： ≥ 500 次
5. 温度范围： $-65^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$
6. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-LP3-0.6-2.54(9-4)

成都恒利泰科技有限公司

 成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	M		标准化	
审核				
工艺			日期	

图样标记

重量

比例

6:1

共 页

第 页